

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

上海矩子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	太平洋证券 刘国清 崔文娟 海通证券 余炜超 吉晟 浙商证券 李思扬 王恬 国泰基金 谢泓材 万家基金 耿嘉洲 束金伟 国华人寿 韩诚 浙商基金 柴明 合众资产 贾文磊 工银安盛资管 牛品 铭基投资 宁铂 丰琰投资 于江勇 泉汐投资 于苏龙 泾溪投资 赵乾明 谭序航 德邻投资 张鑫辉
时间	2020年9月9-11日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 刘阳 证券事务代表 葛燕雯
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况。 矩子科技是业内领先的中高端机器视觉设备供应商，主要

产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备，产品已成功实现进口替代或远销海外。

公司目前已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO 等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。公司产品为通用型设备，海内外客户众多，累计已服务超过 700 家客户。未来也将持续大力开拓海内外市场，并进一步把握我国产业转型升级、制造业提质增效的机遇，加强国内大中型新增客户的开发，进一步提高产品的进口替代率。

二、公司产品的核心技术。

机器视觉设备的核心是公司自主研发设计并拥有自主知识产权的机器视觉软件算法、光学设计以及软硬件相结合的机器视觉系统，包括公司自主开发的 2D/3D 图像处理及模式识别算法、高精度 2D/3D 光学成像系统、多角度彩色照明系统、电气控制系统和伺服驱动高速移动、精准定位系统等等。

公司始终坚持核心技术的积累和持续的技术创新，近两年：

- ✓ 公司在核心技术的自主研发上成功实现了从 2D 机器视觉技术到 3D 机器视觉技术的跨越；基于 3D 机器视觉技术的 3D AOI、3D SPI 已实现批量销售和进口替代。
- ✓ 通过技术迭代优化实现了检测分辨率的进一步提升，从满足 PCBA 的检测要求，提升到了满足 mini LED 的检测要求，进一步提升到了满足半导体后端制程的检测要求。今年上半年起，公司产品已成功地导入了 mini LED 行业。

公司在技术研发方面取得的上述进展进一步提升了公司的核心竞争力，并使得公司具备了向更多新领域拓展的能力。

三、公司 3D 检测业务情况

3D 检测技术难度较高，其市场主要由海外公司垄断。公司在多年前即布局进入 3D 检测领域。经过多年的自主研发和

产品多次迭代优化，公司基于 3D 光学成像及 3D 机器视觉技术的 3D AOI、3D SPI 技术水平和性能已达到国际领先水平，能够与 Koh Young、德律等海外知名公司竞争，并于今年上半年在客户开拓上不断取得突破，打破国外垄断实现了进口替代，获得诸如和硕集团、比亚迪、京东方等行业标杆客户的高度认可，目前在手订单充足。

公司 3D 检测设备采用 3D 数字光栅投影技术与摩尔条纹相位差软件算法，从核心的 3D 光学成像系统到 3D 软件算法均为自主开发，同时产品采用了公司自主开发的运动控制板，进一步提升了系统整体性能。

3D 检测是未来机器视觉的发展方向。3D AOI 在国内尚处于逐渐导入及成长的阶段，随着终端产品对可靠性要求变高，3D AOI 具有巨大的市场发展潜力和前景。而 3D SPI 则已成为电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一，在电子装配制造领域有广泛的应用，但目前市场仍由进口品牌占据，存在较大的进口替代空间，并且其客户与公司原有产品的客户高度重叠。

四、公司其他新产品情况

公司通过多年的自主研发和创新，突破性的推出了通用型的 FPC 软板光学检测设备，实现了高度自动化的针对尺寸各异、不规则形状柔性线路板的检测。目前该产品已经客户评估测试并获得认可。

随着消费电子产品轻薄化趋势日益显现，FPC 软板(柔性电路板)由于重量轻、厚度薄、耐弯曲、结构灵活等优势被全方位地广泛运用。但由于其材质特点，目前 FPC 软板仍采用人工目检的方式进行外观缺陷检测，检测效率低、可靠性低，使用机器视觉检测设备进行检测可以大幅提高生产效率和生产的自动化程度，未来产品市场发展空间广大。

此外，目前公司在开发的产品有：高速药片光学检测设备，

	<p>用于检测药片污染，破损，异物等缺陷；半导体封装自动光学检测设备，针对后端制程的检测，应用于半导体封装测试制程中。</p> <p>五、公司产品竞争环境</p> <p>公司致力于技术门槛较高的通用性机器视觉设备的开发与制造，参与全球市场的竞争，力争成为全球领先的机器视觉设备制造商。</p> <p>公司的主要竞争对手均来自于海外，主要为 Koh Young Technology、德律科技、欧姆龙、Saki Corporation 等国际知名品牌。公司以优秀的产品技术水平、性能、品质及服务与海外品牌直接竞争，且有部分产品较进口品牌在技术指标上存在着优势。公司不进行价格竞争，产品价格与上述国际知名品牌相当。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020 年 9 月 11 日